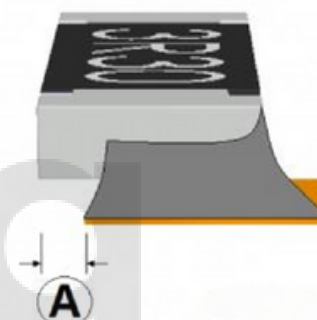


Criterios de Inspección SMT según la norma IPC 610 Clase 3.

Aprende a evaluar la calidad de la soldadura para componentes SMT/SMD de productos militares, aeronáuticos, aeroespaciales de misión crítica

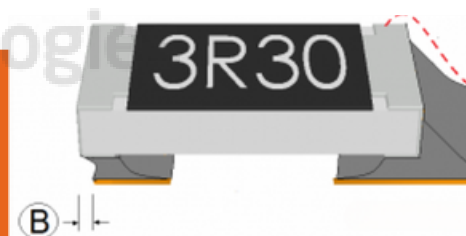
A. Desplazamiento máximo lateral

Menos del 25% del **ancho** de terminación (terminación metalizada o pin) del componente o el 25% del ancho del pad, lo que sea menor.



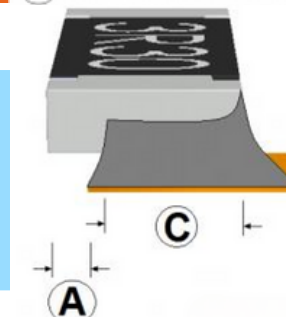
B. Desplazamiento máximo frontal

No permitido.



C. Ancho mínimo de la conexión

(El 75% del **ancho** de terminación del componente o el 75% del pad, lo que sea menor.



D. Longitud mínima de la conexión de lado.

Evidencia de mojado/humectación adecuada.



E. Altura máxima del filete

La soldadura puede **sobresalir** del pad, pero **no debe** tocar la parte no soldada, es decir el cuerpo del componente.



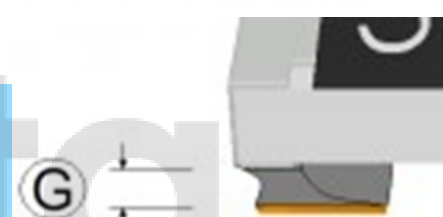
F. Altura mínima del filete

$G + 25\%$ de H (altura terminación) o $G + 0,5\text{mm}$.



G. Espesor mínimo de la soldadura

Evidencia de apropiado mojado/humectación.



J. Traslape mínimo frontal

25% de R (Largo de la terminación)

